

## CAE Molding Conference 2009 巡迴研討會應用論文徵選活動

各位 親愛的用戶您好：

感謝您多年來的支持與愛護，透過與您的合作與交流讓 Moldex3D 成長不少，藉此吸取許多寶貴的實務經驗。由台灣區電腦輔助成型交流協會與科盛科技合辦的「**CAE Molding Conference 2009 巡迴研討會**」，將邀集國內外的領導廠商與學研界專家與會暢談。配合此次盛會，大會特別舉辦「論文徵稿」活動，通過評選的論文將收錄於 CAE Molding Conference 2009 論文集，並頒予獎狀一式，歡迎大家踴躍投稿！詳細活動資訊如下：

- **徵稿對象：**Moldex3D 用戶
- **發表主題：**最佳模流分析成功應用案例之經驗分享
- **評選辦法：**將由大會評選委員會進行文件審核，通過評選的論文即可刊載於 CMC2009 論文集
- **投稿方式：**(1) 中文摘要：2009 年 5 月 22 日前提供  
(2) 中文全文：2009 年 6 月 30 日前提供
- **其他事項：**
  - 入選論文將會收錄至本次研討會論文集和論文資料光碟中
  - 論文檔將於研討會後放至 ACMT 網站討論區中供網站 ACMT 會員下載

### 投稿意願表

ACMT 協會與科盛科技懇請您能共襄盛舉並投稿分享，下表為投稿意願表，如有意願請填寫完後撕下交給與您接洽的業務或回傳科盛科技，感謝配合。

|        |    |       |     |
|--------|----|-------|-----|
| 公司名稱   |    |       |     |
| 投稿者姓名  |    | 部門/職稱 |     |
| 公司電話   |    | 傳真電話  |     |
| E-mail |    |       |     |
| 日期     | 西元 | 年     | 月 日 |

☎ 填寫完畢後請回傳科盛科技留存，謝謝您！

Fax : 03-5600198

☎ 聯絡窗口：曾宏志 先生 03-5600199 ext.703

☎ e-mail : [henrytseng@moldex3d.com](mailto:henrytseng@moldex3d.com)

尚此敬頌

研 安